证券代码:600460 证券简称:士兰微 编号:临2024-042

杭州士兰微电子股份有限公司关于对外投资暨签署《8英寸SiC功率器件芯片制造生产线项目之投资合作协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:厦门士兰集宏半导体有限公司(以下简称“士兰集宏”或“项目公司”)

● 投资金额:杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与厦门半导体投资集团有限公司、厦门新翼科技实业有限公司共同向子公司厦门士兰集宏半导体有限公司增资41.50亿元并签署《8英寸SiC功率器件芯片制造生产线项目之投资合作协议》(以下简称“《投资合作协议》”)。

● 风险提示:1、士兰集宏未来在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响,存在一定的行业和市场风险、经营管理风险等,其未来的经营情况存在一定的不确定性。

2、《投资合作协议》自各方签字盖章后生效。各方对项目公司实缴出资,以各方均已就本次投资获得必要的内部权力机构核准、外部审批、工商登记和/或备案登记和备案为先决条件(除非各方一致同意对部分或全部条件豁免)。

3、本事项尚须获得公司股东大会的批准。

一、对外投资概述

(一)为加快公司在半导体产业链的布局,并落实公司与厦门市人民政府、厦门市海沧区人民政府签署的《战略合作框架协议》,公司与厦门半导体投资集团有限公司、厦门新翼科技实业有限公司于2024年5月21日在厦门市签署了《8英寸SiC功率器件芯片制造生产线项目之投资合作协议》。《投资合作协议》概要如下:

结合各方在技术、市场、团队、运营、资金、区位和区位政策以及营销等方面的优势,各方合作在厦门市海沧区合资经营项目公司 “厦门士兰集宏半导体有限公司”, 以项目公司负责作为项目主体建设一条以SiC-MOSEFET为主要产品的8英寸SiC功率器件芯片制造生产线,产能规模6万片/月。第一期项目总投资70亿元,其中资本金42.1亿元,占约60%;银行贷款27.9亿元,占约40%。第二期投资50亿元,在第一期的基础上实施(第二期项目资本结构暂定其中30亿元为资本金投资,其余为银行贷款。二期项目资本金中,本协议甲乙双方暂定按“1:1原则”追加投资,即按照乙方届时追加投资的金额,甲方合计追加相同的金额,具体以各方届时议定的为准),第二期建成后新增8英寸SiC芯片2.5万片/月的生产能力,与第一期的3.5万片/月的产能合计形成6万片/月的产能。

各方通过项目实施,结合各方的优势,将项目公司建成一家符合国家集成电路产业发展规划、开展以第三代半导体功率器件研发、制造和销售为主要业务的半导体公司,并具有国际化经营能力,以取得良好的经济、社会效益;支撑带动终端、系统、IC设计、装备、材料产业链上下游企业在厦门集聚,为中国集成电路产业发展助力。

(二)士兰集宏本次新增注册资本41.50亿元,由本公司与厦门半导体投资集团有限公司、厦门新翼科技实业有限公司以货币方式共同认缴,其中:本公司认缴10亿元,厦门半导体投资集团有限公司认缴10亿元,厦门新翼科技实业有限公司认缴21.50亿元。本次出资无溢价。本次增资完成后,士兰集宏的注册资本将由0.60亿元增加至42.10亿元。

本次增资前后士兰集宏的股权结构如下:

股东名称	增资前		增资后	
	认缴注册资本(万元)	持股比例(%)	认缴注册资本(万元)	持股比例(%)
杭州士兰微电子股份有限公司	6,000	100.00	106,000	25.1781
厦门半导体投资集团有限公司			100,000	23.7530
厦门新翼科技实业有限公司			215,000	51.0689
合计	6,000	100.00	421,000	100.00

(三)公司于2024年5月20日召开的第八届董事会第二十四次会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于签署(8英寸SiC功率器件芯片制造生产线项目之投资合作协议)的议案》。本议案尚须提交公司股东大会审议,董事会同时提请股东大会授权董事长陈向东先生,在该投资协议框架下,根据项目的实际进度签署相关法律文件(包括但不限于增资协议、章程等)并实施本项目相关事宜。

(四)本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称	厦门士兰集宏半导体有限公司
统一社会信用代码	91350205MADBPM9123
成立日期	2024年3月6日
注册地址	厦门市海沧区廈灶路103号6层之九
法定代表人	陈向东
注册资本	6,000万元(已足额缴纳)
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	集成电路设计;集成电路芯片及产品制造;集成电路制造;集成电路销售;半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;光电子器件制造;光电子器件销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;半导体器件专用设备销售;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;电子产品销售
股权结构	杭州士兰微电子股份有限公司持有100%股权

士兰集宏“8英寸SiC功率器件芯片制造生产线项目(一期)”已于2024年5月取得《厦门市企业投资项目备案证明》(编号:厦海发投备(2024)263号)。

三、投资协议主体的基本情况

(一)厦门半导体投资集团有限公司

公司名称	厦门半导体投资集团有限公司
统一社会信用代码	91350200MA2XUDEM91
成立时间	2016年12月9日
注册地址	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景中路43号201单元
法定代表人	裴华
注册资本	505,648万元
企业类型	有限责任公司(国有控股)
主营业务	投资管理、资产管理、投资管理咨询、产业投资等
主要股东	厦门海沧发展集团有限公司持有51%的股权 厦门海沧投资集团有限公司持有49%的股权
实际控制人	厦门市海沧区人民政府

(二)厦门新翼科技实业有限公司

公司名称	厦门新翼科技实业有限公司
统一社会信用代码	91350200MADM8WPK4B
成立时间	2024年5月20日
注册地址	厦门火炬高新区软件园三期诚毅北大街56号402室-233
法定代表人	林瑞进
注册资本	500,000万元
企业类型	有限责任公司(国有控股)
主营业务	科技推广和应用服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;企业管理;企业管理咨询。
主要股东	厦门海翼集团有限公司持有60%的股权 厦门市产业投资有限公司持有40%的股权
实际控制人	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

四、《投资合作协议》的主要内容

(一)协议各方

甲方1:厦门半导体投资集团有限公司

甲方2:厦门新翼科技实业有限公司

乙方:杭州士兰微电子股份有限公司

上列签约方单称为“一方”、合称为“各方”;甲方1、甲方2或合称为“甲方”,甲方、乙方或并列称为“甲乙双方”。

项目公司:厦门士兰集宏半导体有限公司

(二)投资步骤主要内容

1、投资前提:甲方、乙方对项目公司实缴出资,以下列条件完成为先决条件(除非各方一致同意对部分或全部条件豁免):各方均已就本次投资获得必要的内部权力机构核准、外部审批、工商登记和/或备案登记和备案。

2、投资方案

为加快推动本项目进度,乙方已于2024年3月6日在厦门市海沧区先行设立了项目公司“厦门士兰集宏半导体有限公司”。项目公司目前注册资本为6000万元,全部由乙方以货币出资。目前项目公司的股权结构如下:

序号	股东	认缴注册资本(万元)	出资形式	持股比例
1	杭州士兰微电子股份有限公司	6000	货币	100%
合计		6000	--	100%

甲乙双方同意(并且乙方应负责确保项目公司同意)甲方按照本协议的约定以增资方式入股项目公司(以下简称“本次增资”)。项目公司在本次增资后的注册资本增加至42.1亿元,其中:甲方以货币合计出资31.5亿元;乙方以货币出资10.6亿元。项目公司在本次增资后的股权结构如下:

序号	股东	认缴注册资本(万元)	出资形式	持股比例
1	厦门半导体投资集团有限公司	100000	货币	23.7530%
2	厦门新翼科技实业有限公司	215000	货币	51.0689%
3	杭州士兰微电子股份有限公司	106000	货币	25.1781%
合计		421000	--	100%

本次增资中,若甲方向项目公司增资确需进行专业尽职调查和审计、评估等有关程序的,甲乙双方配合按照有关规定履行相关程序。

乙方保证并承诺,直至本次增资前,项目公司依法注册成立并且保持合法存续,过往经营管理始终合法合规。

3、出资时间

甲方登记为项目公司股东后(自项目公司就本次增资事项取得营业执照之日起计,下同),甲方、乙方应在2026年6月30日前以货币方式缴足各自认缴的全部注册资本。认缴期内,各方应根据项目公司的资金需求情况和相关合作协议等安排,同时按出资比例分期缴足出资,甲方对项目公司的实缴出资进度比例与乙方当期的实缴出资进度比例相同。

各方应依约及时将出资款汇入项目公司开立的专用银行账户。

4、相关手续办理

(1)各方同意,每一次出资完成后由项目公司负责委托具有资质的会计师事务所对各方的出资进行验资并出具相应的验资报告,并委派人员办理相应的工商变更登记手续。

(2)各方应在投资前提达成后30日内签署项目公司增资相关协议与章程。

(四)各方承诺事项

1、甲方承诺事项

除履行其在本协议项下的其他义务外,甲方还应陈述、保证及承诺以下事项:

(1)甲方已依法注册成立并且合法存续,具有依照法律法规及其相应的治理架构规定和决策文件签署本协议的权利能力和行为能力,已根据法律法规、相关内外部规定采取必要的行为进行适当授权,并有足够的能力全面履行本协议规定的义务;

(2)本协议的签署和履行不与甲方所适用的有关法律、法规、条例、内外部规定等有约束力的规范性文件及签订的任何协议所承担的义务相冲突;

(3)保证按照本协议的约定和相关法规的规定,积极配合办理项目公司注册、登记等相关手续;

(4)按照本协议的规定缴付所认缴的项目公司的出资;

(5)负责与厦门市、海沧区相关部门的协调和沟通工作,协助项目公司得以顺利设立、建设和运行;

(6)配合协助项目公司涉及与国家政策性银行、地方商业银行等金融机构融资、担保等事宜的协调解决;

(7)配合协助项目公司开展各项前期工作,包括但不限于项目公司筹建事务、优惠政策的争取以及与项目公司设立有关的注册、登记或报批手续;协助项目公司和乙方办理项目建设用地、土建、其它项目建设等所需的批准手续等;

(8)促使项目公司依法进行备案或审批,支持加快项目建设进度,协助项目公司及乙方落实相关优惠政策。

2、乙方承诺事项

除履行其在本协议项下的其他义务外,乙方还应陈述、保证及承诺以下事项:

(1)乙方是依法注册成立并且合法存续的企业法人,具有依照法律法规及其公司章程签署本协议的权利能力和行为能力,已根据法律法规及乙方公司章程规定采取必要的公司行为进行适当授权,并有足够的能力全面履行本协议规定的义务;

(2)按照本协议的规定缴付所认缴的项目公司的出资;

(3)本协议的签订或履行不违反以其为一方的任何合同或协议;

(4)负责本项目各方的协调和沟通工作;

(5)自本协议生效之日起一年内,负责组建相对完善的项目公司运营管理团队(包括但不限于管理层人员以及生产、销售、研发等支撑项目公司正常运转的团队),以承担项目公司日常运营管理,确保项目公司尽快运作;

(6)为项目公司生产运营之必要,授权项目公司使用乙方已取得的相关专利、专有技术;

(7)保证按照本协议的约定和相关法规的规定,配合项目公司开展各项前期工作,包括但不限于项目公司筹建事务、优惠政策的争取以及与项目公司设立有关的注册、登记或报批手续;协助项目公司办理项目建设用地、土建、其它项目建设等所需的批准手续等。

(五)关于公司治理架构的主要内容

1、项目公司将依据《中华人民共和国公司法》以及公司章程建立公司法人治理结构,股东会为项目公司最高权力机构。

2、董事会:项目公司设立董事会,董事会由7名董事组成。其中,甲方1提名1名董事,甲方2提名2名董事,乙方提名4名董事,由股东会选举产生。董事长为项目公司法定代表人,董事长由甲方1提名的董事担任,由董事会选举产生。乙方按本协议完成第一步收购后,董事长由乙方提名的董事担任。

3、经营管理人员:项目公司设立董事会领导下的以总经理为首的经营管理团队,经营管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员,由乙方提名和推荐,并经董事会聘任或解聘。

4、监事会:项目公司设立监事会,监事会成员共3名,其中甲方2提名1名监事,乙方提名1名监事,职工监事1名,监事长由乙方提名的监事担任,由监事会选举产生。

5、股东会决策机制

项目公司下列事项的决定需经代表超过五分之四表决权的股东表决同意方为有效,但本协议其它条款有特别约定的除外:

(1)修改项目公司章程;

(2)对项目公司增加或者减少注册资本作出决议;

(3)对项目公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议;

(4)决定项目公司的经营方针和投资计划;

(5)审议批准各股东以项目公司股权对外质押事项;

(6)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;

(7)审议批准项目公司的年度财务预算方案、决算方案;

(8)审议批准项目公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(9)对项目公司发行公司债券作出决议;

(10)审议项目公司重要对外投资(认定标准为对同一项目或企业累计投资金额人民币1,000万元以上的情况);

(11)对项目公司的业务范围和/或主营业务方向发生重大改变、从事主营业务以外的业务作出决议;

(12)审议批准项目公司为股东或其实际控制人、股东或其实际控制人控制的其他企业提供担保,为除股东或其实际控制人、股东或其实际控制人控制的其他企业以外任意第三方提供大于100万元人民币的担保;

(13)审议批准项目公司知识产权、商标、土地使用权、房产等重大资产的处置(认定标准为评估价值人民币1,000万元以上的土地、房产、股权、知识产权等资产);

(14)审议批准项目公司的上市计划,包括中介机构(券商、保荐代表、会计师事务所、律师事务所)的聘用、上市主体、上市时间、地点、价格等;

(15)审议批准订立任何投机性的互换、期货或期权交易,进行委托理财、委托贷款事项;

(16)审议批准项目公司的重大资产重组(认定标准为任何与项目公司相关的、评估价值超过上一年经审计的项目公司净资产30%的资产控制权发生变更的事项);

(17) 审议批准单笔金额1000万元以上或累计占项目公司最近一期经审计净资产绝对值20%以上的关联交易。

涉及前述(1)至(5)项的修改或决议或决定,需经各方一致同意方可通过。

除上述约定事项外,其他法律法规或项目公司章程规定的其他股东会决策事项,则需经代表超过三分之二表决权的股东表决同意。

6、项目公司下列重要事宜需要经全体董事一致同意方可通过,但本协议其它条款有特别约定的除外:

(1)召集股东会会议,并向股东会报告工作;

(2)执行股东会的决议;

(3)决定项目公司的经营计划和投资方案;

(4)制订项目公司的年度财务预算方案、决算方案;

(5)制订项目公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(6)制订项目公司增加或者减少注册资本以及发行项目公司债券的方案;

(7)制订项目公司合并、分立、解散或者变更项目公司形式的方案;

(8)决定项目公司内部管理机构的设置;

(9)决定聘任或者解聘项目公司总经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘项目公司副总经理、财务负责人及其报酬事项;

(10)制定项目公司的基本管理制度;

(11)审议批准项目公司为除股东或其实际控制人、股东或其实际控制人控制的其他企业以外任意第三方提供不超过100万元的担保。

(12) 审议批准单笔金额低于1000万元或累计占项目公司最近一期经审计净资产绝对值低于20%的关联交易;

(13)项目公司章程规定的其他职权。

除上述约定事项外,其他法律法规或项目公司章程规定的其他董事会决策事项,则需经三分之二以上董事表决同意。

(六)关于股权转让和增资

1、甲方持有的项目公司股权根据本协议之约定被乙方收购完成之前,未经乙方以书面形式同意,甲方中的任一方不得向任意第三方转让股权 (但甲方中的任一方向其同一实控人控制的关联方或甲方中的其他一方转让的情形除外,特别的,该受让实体与乙方及项目公司不从事与项目公司相同或近似的业务、不存在竞争关系为前提,且需继续承继出让方在本协议中的义务),未经甲方均予书面形式同意,乙方不得向任意第三方转让股权,前述股权转让均包括但不限于以协议方式而不办理工商变更登记的转让或其他类似安排,本协议另有约定的除外。

2、优先认购权

项目公司设立完成后进行增资扩股的,甲乙双方有权按所持股权比例享有优先认购权,本协议另有约定的除外。

3、优先受让权

各方同意,在受限于本协议本条第1款的前提下,项目公司设立完成后,一方进行股权转让的,在同等价格和条件下,另一方享有优先受让权(但甲方中的任一方向甲方中的其他一方转让的情形除外)。项目公司改制为股份有限公司时,同样适用本条约定。但一方以书面形式通知另一方放弃优先受让权或经通知后三十日内未作回应的情形除外。

4、共同出售权

在不违反本协议有关约定的情况下,如果乙方拟向甲方以外的其他受让方(乙方控制实体除外)出售其所持有项目公司的股权,则甲方有权以与乙方拟向受让方转让股权相同的价格、条款和条件,向受让方出售甲方持有的部分或全部项目公司股权,且乙方应有义务促使受让方以该等价格、条款和条件购买甲方所持有的项目公司股权。

(七)关于受让与收购的主要内容

1、在约定时间内,乙方应且甲方同意按照以下表格中的顺序要求受让甲方所持有的项目公司的部分股权,受让时间、比例、价格等条件具体如下:

顺序	时间	受让方	转让方	转让股权比例(%)	价格
第一步	项目公司产线正式投产产出后7年内或达到盈亏平衡起1年内	乙方	甲方	甲方转让后乙方所持项目公司的股权比例不低于51%	该等出让股权所对应的投资本金与资源占用费之和(资源占用费=投资本金×投资期限×年化3.95%)
第二步	第一步完成(以完成股权转让工商变更登记为准)后3年内,且最迟不超过第一步受让时点到达后5年内	乙方	甲方	甲方转让后乙方所持项目公司的股权比例为75%	该等出让股权所对应的投资本金与资源占用费之和(资源占用费=投资本金×投资期限×年化3.95%)

启动转让事宜以乙方按照上表约定的条款和条件向甲方出具正式书面受让通知书(须盖章)的日期为准。乙方应在上述受让条件到达后180日内,付清按照本协议约定计算的股权转让价款。按上表约定的条款和条件,乙方启动受让股权后,甲方必须按照上表约定的转让股权比例和价格配合股权转让,甲乙双方共同完成股权转让工作。各步转让中,甲方需转让的股权数量,按甲方1、甲方2之间相对股比分配给各甲方履行,或以各甲方届时另行议定的分配比例为准。

本款所述“投资期限”指自甲方实缴注册资本之日至收到股权转让款项之日,分期缴付注册资本的,按照注册资本实际到资之日分别计算。

2、如果乙方未按照以上第1款约定之时间和/或条件启动受让甲方股权工作,且在甲方书面通知后60日内未纠正的,则针对该等股权,甲方可自主选择其它退出方式(包括但不限于向第三方转让所持有的股权),乙方予以配合。

3、在甲方持有项目公司股权期间,若出现协议约定以下的重大经营缺陷之一情形的,甲方有权要求乙方立即受让甲方所持项目公司的全部或部分股权:

(1)未经甲方书面同意或者股东会决议,乙方擅自将项目公司的重要资产(认定标准为评估价值超过人民币5,000万元的土地、房产、知识产权、持有其他企业的股权等资产)转让至任意第三人名下。

(2)未经各方同意或者股东会决议,项目公司主营业务发生实质性变化,即不再从事本协议约定的项目公司主营业务。

受让价格为甲方按本协议签署时人民银行公布的最新的5年期以上LPR利率固年化3.95%计算的投资本金和收益之和。股权转让或收购之前项目公司已向甲方分配的股息、红利将从上述收购或受让价格中扣除,股权收购之时应分配但未分配给甲方的股息、红利,应统一计算并分配给甲方,即,股权收购或受让总价款=甲方投资本金×(1+3.95%×n)-项目公司历年累计向甲方实际支付的股息、红利,其中:n=投资年数,投资年数按照实际投资期限的天数除以365计算。

4、当第3款所述的触发受让或收购的条件成立,并且有选择权的一方要求执行本协议所约定的受让或收购条款时,另一方应予以配合执行,并在股权受让或收购通知书送达后的15个工作日内给予正式回应。股权的受让或收购所涉及的价款支付,应在股权受让或收购通知书送达被要求方之日起30个工作日内完成;同时相应的工商变更登记手续应在股权受让或收购价款支付之后的20个工作日内完成。如因一方违约导致超过上述期限的,在另一方书面提示或催促后30日内未改正的,每超过一天,违约方除支付受让或收购金额以外,还应按逾期支付金额,以5%的年化利率按逾期履行日数向守约方支付违约金。

5、在各方持有项目公司股权期间,各方按照各自的持股比例,分享项目公司经营成果,分担项目公司经营风险。

(八)其他主要规定

1、生效:本协议自各方盖章及其授权代表签字后生效。

2、约束范围:如甲方实际的出资主体为经乙方同意的甲方控制的实体,本协议项下甲方的权利义务由甲方实际的出资主体承继。

本协议对本协议各方以及该方合法的继受者、受让人和实际控制人有法律拘束力。

3、修改:本协议不得以口头方式修改,而须各方签署书面文件后方可修改;若相关法律另有规定,则须签署书面文件并取得相关审批机关的批准,本协议方可修改。

4、法律适用及争议解决:本协议的效力、解释以及执行适用中华人民共和国法律。凡因履行本协议而发生的一切争议,各方首先应通过友好协商的方式加以解决。如果该项争议在开始协商后九十(90)日内未能达成一致的解决方案或者谅解,任何一方均可向上海仲裁委员会提起仲裁,并由该会依据中华人民共和国仲裁法、其他法律、法规、规章、规范性文件以及该会当时合法有效的仲裁规则进行仲裁。

5、协议还规定了“知识产权和商业秘密”、“保密义务”、“不可抗力”等其他条款。

五、对外投资对上市公司的影响

如本次投资事项顺利实施,将为士兰集宏“8英寸SiC功率器件芯片制造生产线项目”的建设和运营提供资金保障,有利于加快实现公司SiC功率器件的产业化,完善公司在车规级高端功率半导体领域的战略布局,增强核心竞争力,有利于抓住当前新能源汽车产业的发展契机,推动公司主营业务持续成长。本次投资事项建设周期较长,对上市公司当期业绩无重大影响。

六、对外投资的风险分析

(一)士兰集宏未来在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响,存在一定的行业和市场风险、经营管理风险等,其未来的经营情况存在一定的不确定性,具体如下:

1、行业和市场风险

当前新能源产业飞速发展,市场对汽车级SiC功率器件产品的需求量迅速放大,但新能源产业的发展受到宏观经济、政策支持、技术演进等因素的影响,可能会阶段性不达预期。

针对行业和市场风险,公司将充分发挥IDM模式的优势,加强芯片设计、制造和封装的协同,并通过加强与下游大客户的合作,不断开发出具有世界先进水平的产品,稳步扩大产能,持续提升市场份额。

2、经营管理风险

未来随着新能源市场的扩大,不排除有更多的竞争者加入,可能会对产品的价格产生不利影响。同时新能源汽车厂商对车规级产品要求严苛,项目公司的经营管理将面临新的挑战。

针对经营管理风险,公司将帮助和配合士兰集宏,通过吸引人才,加快创新,优化流程,持续提升经营管理水平;同时不断提高生产工艺技术水平,加强成本控制,保障产品质量。此外,公司将加强产品系列化开发,提高产品附加值。

(二)《投资合作协议》自各方签字盖章后生效。各方对项目公司实缴出资,以各方均已就本次投资获得必要的内部权力机构核准、外部审批、工商登记和/或备案登记和备案为先决条件(除非各方一致同意对部分或全部条件豁免)。

(三)本事项尚须获得公司股东大会的批准。

后续公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险!

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2024年5月22日

证券代码:600460 证券简称:士兰微 公告编号:临2024-043

杭州士兰微电子股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年6月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年6月6日 14点00分

召开地点:浙江省杭州市西湖区黄姑山路4号公司三楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年6月6日

至2024年6月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于签署《8英寸SiC功率器件芯片制造生产线项目之投资合作协议》的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年5月20日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过。会议决议公告已于2024年5月22日刊登在本公司指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:无

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600460	士兰微	2024/6/3

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

3、股东可用传真、信函或电子邮件方式进行登记,须在登记时间2024年6月4日下午16:30前送达,传真、信函或电子邮件登记需附上上述1、2所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。传真、信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准,并请在传真、信函或电子邮件上注明联系电话。

4、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)。

(二)登记地点:浙江省杭州市西湖区黄姑山路4号三楼投资管理部

(三)登记时间:2024年6月4日上午9:30-11:30,下午1:30-4:30

(四)联系方式:

联系人:马先生、陆女士、张女士

联系电话:0571-88212980

传真:0571-88210763

电子邮箱:600460@silan.com.cn

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。

(二)出席现场会议的股东及股东代表食宿费及交通费自理。

(三)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,准时参会。

(四)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2024年5月22日

附件1:授权委托书

授权委托书

杭州士兰微电子股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月6日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于签署《8英寸SiC功率器件芯片制造生产线项目之投资合作协议》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人或受托人的联系电话:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600460 证券简称:士兰微 编号:临2024-040

杭州士兰微电子股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议于2024年5月20日以通讯的方式召开。本次董事会已于2024年5月15日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员,并电话确认。会议应到董事12人,实到12人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议:

1、同意《关于签署(战略合作框架协议)的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临2024-041。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,获得一致通过。

2、同意《关于签署(8英寸SiC功率器件芯片制造生产线项目之投资合作协议)的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临2024-042。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,获得一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

3、同意《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临2024-043。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,获得一致通过。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2024年5月22日

证券代码:600460 证券简称:士兰微 编号:临2024-041

杭州士兰微电子股份有限公司关于签署《战略合作框架协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本协议为各方深化合作、围绕项目达成战略合作的总体框架。项目所涉具体合作内容、方案,需经各方完成各自的内部审批流程后,以各方另行签署的投资合作协议等为准。

公司拟与相关主体签署的投资合作协议请详见公司于同日披露的《关于对外投资暨签署(8英寸SiC功率器件芯片制造生产线项目之投资合作协议)的公告》(公告编号:临2024-042),该事项尚须获得公司股东大会批准,存在一定的不确定性。

● 本协议的签订不会对公司2024年度业绩产生影响。

一、框架协议签订的基本情况

(一)协议各方:

1、厦门市人民政府(以下简称“甲方1”)

2、厦门市海沧区人民政府(以下简称“甲方2”,“甲方1”和“甲方2”合称“甲方”)

3、杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)

(二)杭州士兰微电子股份有限公司与厦门市人民政府、厦门市海沧区人民政府本着平等互利、优势互补、共谋发展的原则,经友好协商于2024年5月21日在厦门市签署了《8英寸SiC功率器件芯片制造生产线项目战略合作框架协议》(以下简称“《战略合作框架协议》”)。

(三)公司于2024年5月20日召开的第八届董事会第二十四次会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于签署(战略合作框架协议)的议案》。

二、框架合作协议的主要内容

(一)合作内容

1、集成电路产业是厦门新一代信息技术产业的核心基础产业。为抓住中国集成电路产业发展的战略机遇期,共同打造符合国家集成电路产业发展规划、厦门集成电路产业发展规划纲要的特色工艺芯片企业,深化各方在厦门市海沧区的产业合作,发挥各方在区位、政策、技术、运营、市场、资本和产业生态上的综合优势,各方合作在厦门市海沧区投资建设一条以SiC-MOSEFET为主要产品的8英寸SiC功率器件芯片制造生产线(以下简称“该项目”)。

2、该项目分两期建设,项目一期投资规模约70亿元,二期投资规模约50亿元,两期建设完成后,将在厦门市海沧区形成8英寸碳化硅功率器件芯片年产72万片的生产能力,培育一家符合国家集成电路产业发展规划、开展以第三代半导体功率器件研发、制造和销售为主要业务、具有国际化经营能力的半导体公司。

(二)项目资源配置

1、乙方将向项目充分导入乙方在特色工艺芯片生产线和先进化合物半导体器件生产线技术、市场、人才、运营等方面的优势,结合厦门政策、区位、产业链、综合环境等优势,为产业链上下游企业提供相关产品、技术支撑与服务。

2、甲方为项目提供包括基础设施配套、建设服务、金融服务、人才服务和员工子女教育等方面的支持,并协助项目落地、验收和持续发展。

3、各方共同落实本协议所涉各项合作。

(三)其他事项

本协议为各方深化合作、围绕该项目达成战略合作的总体框架。项目所涉具体合作内容、方案,需经各方完成各自的内部审批流程后,以各方另行签署的投资合作协议等为准。

三、对上市公司的影响

本协议的签订,有利于充分发挥公司在设计制造一体化模式(IDM)中长期积累的独特优势,进一步完善公司在半导体产业链的布局,持续提升核心竞争力,符合公司长期发展战略规划。

本协议的签订不会对公司2024年度业绩产生影响。

四、重大风险提示

本协议为各方深化合作、围绕项目达成战略合作的总体框架。项目所涉具体合作内容、方案,需经各方完成各自的内部审批流程后